

Pracoviště: Katedra elektromechaniky a výkonové
elektroniky, RICE

Výzkumná zpráva č.:

Tepelná simulace IGBT modulu

Druh úkolu: Vědeckovýzkumný

Řešitelé: Ing. Marek Stejskal

Vedoucí úkolu:

Počet stran: 16

Datum vydání: březen 2017

Revize: 1

Anotace

Zpráva se zabývá simulací ohřevu rozložení tepelného pole v IGBT modulu půlmůstku a na chladiči a jejím porovnání s naměřenými hodnotami. Zpráva obsahuje simulace, měření a jejich vzájemné srovnání.